香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd.
上海天數智芯半導體股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9903)

自願公告
綜合銀行授信

本公告由上海天數智芯半導體股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)自願作出，旨在向本公司股東(「**股東**」)及潛在投資者提供有關本集團最新發展的資料。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此知會股東及潛在投資者，於本公告日期，本集團獲多家銀行授予之綜合銀行授信總額超過人民幣120億元。

該等銀行授信額度涵蓋營運資金貸款、銀行承兑匯票、信用證、保函、貿易融資等各類銀行融資產品。銀行授信額度於各自的授信有效期內可循環動用。授信項下融資的實際條款(包括利率、期限、抵押或擔保安排等)以本集團與相關銀行正式訂立的授信協議為準。

董事會謹此感謝股東及投資者一直以來對本公司的支持，並提示：銀行授信總額不等於本集團的實際借款或未償還貸款餘額。實際提取及動用的銀行授信將視乎本集團業務發展及現金管理需要而定。於本公告日期，超過80%的銀行授信額度尚未動用。

上述銀行授信將為本集團日常營運、業務擴張及項目投資提供資金支持，有助優化本集團融資渠道，增強本集團財務靈活性。銀行授信安排不會對本集團的業務營運及財務狀況造成任何重大不利影響。本公司將繼續致力發展業務，為股東創造價值。

除本公告所披露者外，就銀行授信並無其他須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》予以披露的資料。

本公司股東及潛在投資者買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
上海天數智芯半導體股份有限公司
董事會主席
蓋魯江先生

香港，2026年10月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蓋魯江先生、孫怡樂先生、劉崢先生及楊磊先生；非執行董事王晨先生及丁俊博先生；及獨立非執行董事滕勇博士、任今濤先生及王燕博士。